



W-GM-4200

Wafer Edge Grinding Machine

- ベストセラー機 W-GM シリーズ
- コンパクトな設計でスペース効率アップ
- X軸・Y軸・ θ 軸の同期補完制御による高精度な研削
- タッチパネルによる簡単操作
- シリコンの他、脆性材料を含む各種化合物材料に対応



株式会社 東精エンジニアリング

W-GM-4200 仕様

基本仕様		
ウェーハサイズ	φ 2" ~ φ 6" / φ 5" ~ φ 8"	
ウェーハの厚み	0.4 ~ 1.0mm (標準)	
ウェーハの形状	OF、CF × 2 (<1/2 OF) / ノッチ (オプション)	
研削部	2 ステージ	
外周加工用砥石形状	砥石溝径	φ 200mm
	砥石外径	φ 202mm
	内径	φ 30mm
	フランジ厚み	20mm
外周加工用砥石周速 (φ 202)	2500m/min (最大)	
研削スピード	外周部、オリフラ部、ノッチ部で個別に設定可能	
外周加工用スピンドル	φ 5" ~ φ 8" : ビルトインモータ方式 φ 2" ~ φ 6" : ベルトドライブ方式	
操作パネル	12" カラー LCD タッチパネル	
シグナルタワー	3 色表示灯	
装置寸法	2115 (W) x 1410 (D) x 2000 (H) mm	
装置重量	約 3000kg	
機構部仕様		
研削テーブル X, Y, Z 軸	分解能	1 μm
研削テーブル θ 軸	分解能	0.001°
	駆動方式	ハーモニックドライブ & AC サーボモータ
トランスファ部	搬送方式	吸着搬送 (上面)
洗浄部	洗浄方式	スピン洗浄
	乾燥方式	ドライエアー
供給部・収納部	方式	カセットキャリア
	カセット数	4 カセット
測定部仕様		
ウェーハ厚さ測定	分解能	1 μm
	繰り返し測定精度	± 2 μm 以内
	測定方法	非接触式または接触式
	測定機	接触式: 東京精密製 ミニアックス (モアレスケール) 非接触式: 東京精密製 キャディコム (静電容量センサ)
非接触式 アライメント機構	方式	レーザー方式
	分解能	1 μm
	センタリング精度	± 50 μm 以内

株式会社 東精エンジニアリング

東精エンジニアリング

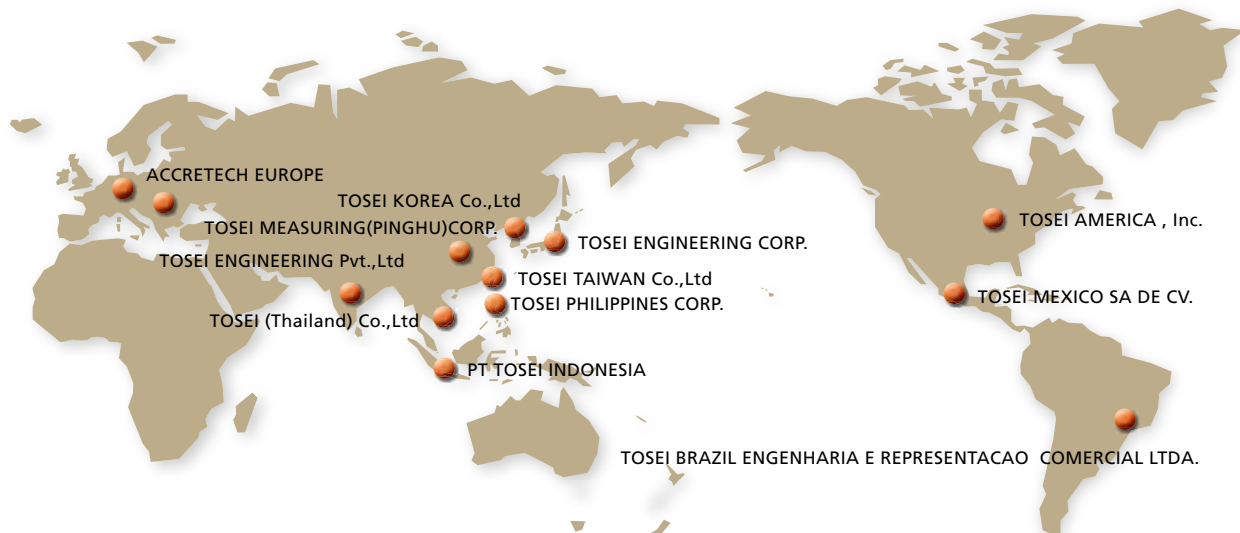
(本社)

〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町 4-6
TEL.029-830-1888 FAX.029-830-1881

(土浦工場 専用機事業部)

〒300-0015 茨城県土浦市北神立町 2-14
TEL.029-830-1882 FAX.029-832-5742

海外拠点 OVERSEAS NETWORK



URL <http://www.toseieng.co.jp/>